

請求の範囲

- [請求項1] 銀粒子と、当該銀粒子の表面に被着する、銀よりも融点が低い金属酸化物を含む被着物と、を有する、銀粉。
- [請求項2] 前記金属酸化物がT e酸化物、B i酸化物、P b酸化物、T l酸化物およびV酸化物の少なくとも1つである、請求項1に記載の銀粉。
- [請求項3] 前記金属酸化物を構成する金属成分の含有量は、銀に対して0.01質量%～10質量%である、請求項1又は2に記載の銀粉。
- [請求項4] 前記被着物は、前記金属酸化物を第1被着物としたとき、前記金属酸化物を構成する金属成分からなる金属または当該金属成分と銀との合金を含む第2被着物を有する、請求項1乃至3に記載の銀粉。
- [請求項5] 前記金属成分がT e、B i、P b、T l、Vの少なくとも1つである、請求項4に記載の銀粉。
- [請求項6] 前記被着物における前記金属酸化物を構成する、銀を除く金属成分の総量は、銀に対して0.1質量%～10質量%である、請求項1～5のいずれか1項に記載の銀粉。
- [請求項7] 銀錯体溶液に、還元剤と、銀よりも融点が低い金属酸化物を構成する金属成分を含む水溶液とを添加する工程を有し、
銀粒子を還元析出させつつ、当該銀粒子の表面に前記金属成分の金属酸化物を析出させて被着させる、請求項1に記載の銀粉の製造方法。
- [請求項8] 請求項1～6に記載の銀粉と、金属を含有する被着物を表面に有さない銀粉と、有機バインダと、ガラスフリットと、溶剤と、を含む導電性ペースト。
- [請求項9] 請求項1～6に記載の銀粉に含まれる、前記金属酸化物を構成する前記金属成分の含有量が、前記導電性ペーストに含まれる銀に対して0.001質量%～0.03質量%である、請求項8に記載の導電性ペースト。